

層数: 2
基材: FR4
板厚: 1.57 mm ± 10%
最小孔径: 1 mm
加工: ENIG (Au:2-5u \"
Soldermask (色): 黒, LPI (色)
最小径 (mm): 0.2, 0.25

加工条件

加工: 銅 厚 銅 厚 IPC-6012 銅 厚 銅.
銅 3-6uM 銅.050uM 銅 銅.

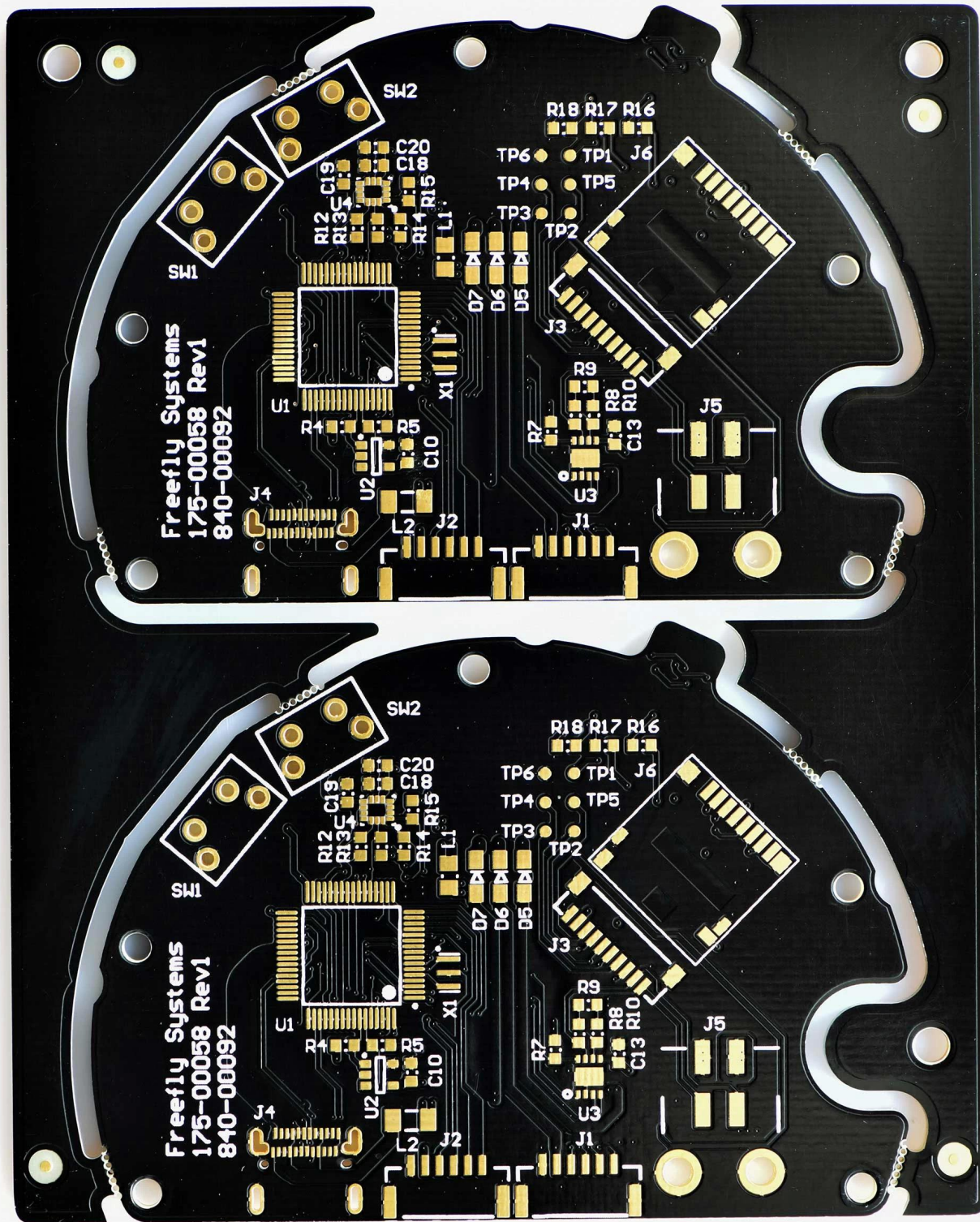
銅 銅 銅.025 AVG,.020 銅... 銅.500 銅銅 銅 銅 銅 銅, 銅 銅 銅 銅 銅銅.

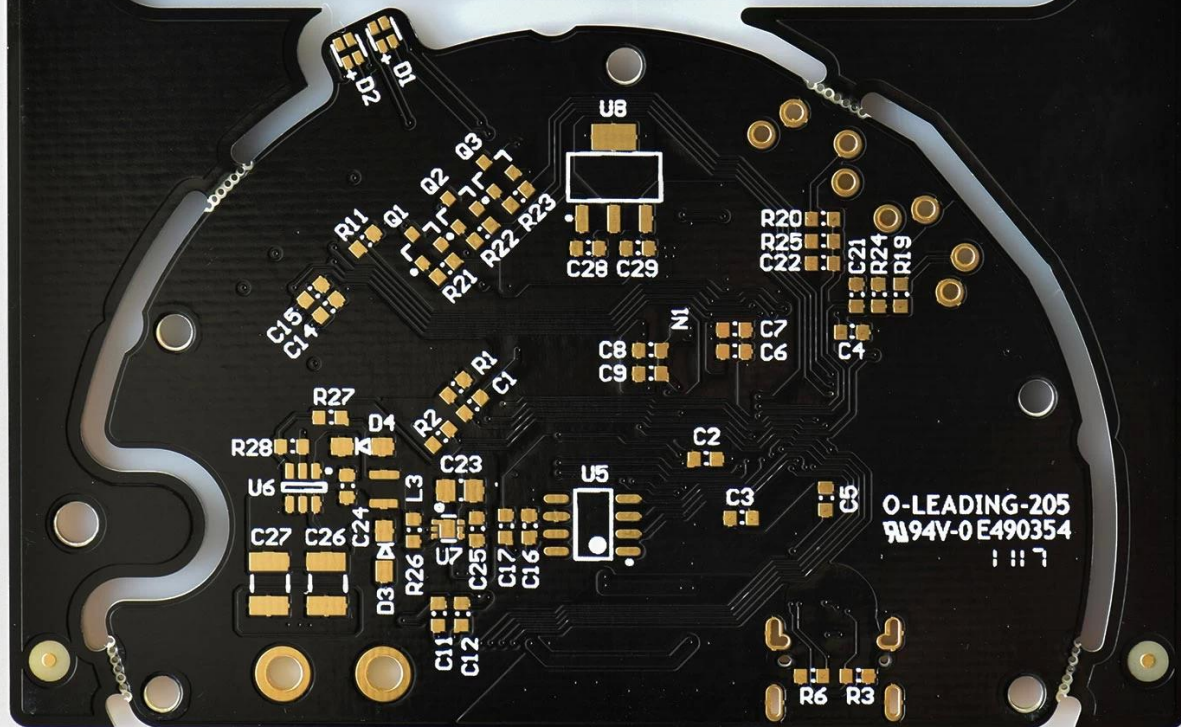
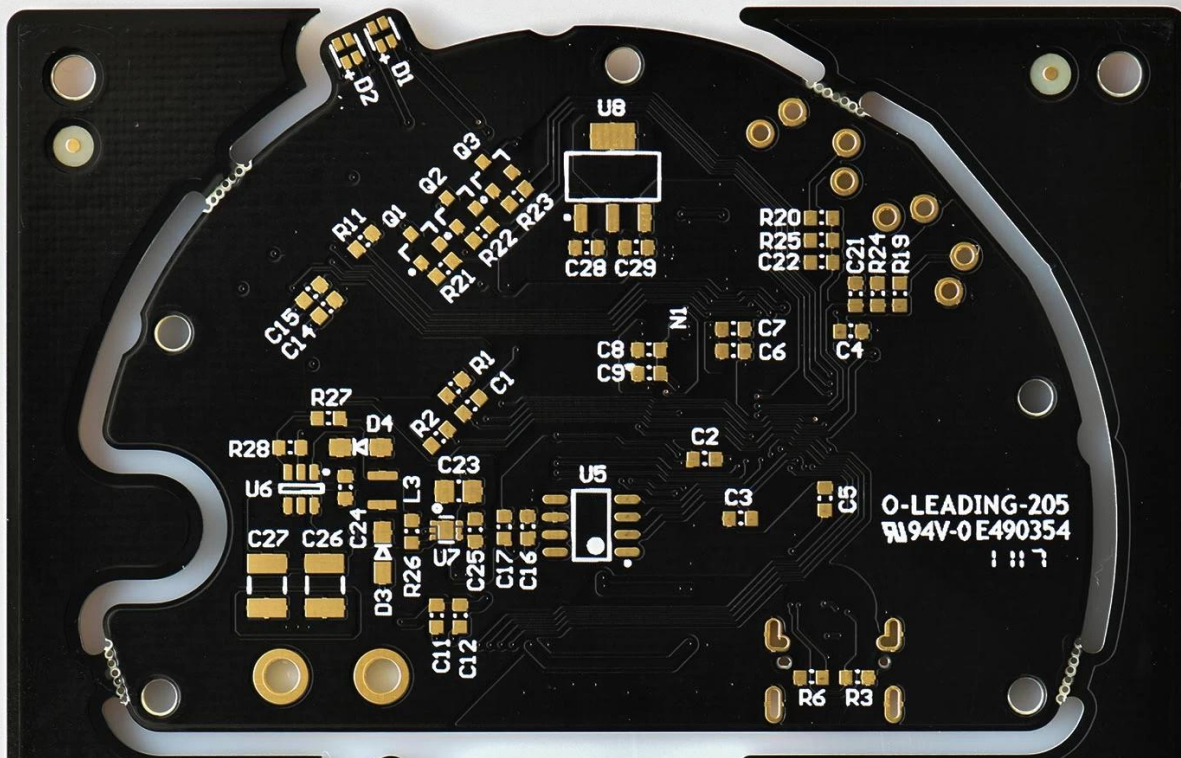
加工条件:

=====

*. GM4: 銅 銅
*. TXT: NC 銅 銅

*. GTP: 銅 銅銅
*. GTO: 銅 銅 銅
*. GTS: 銅 Soldermask
*. GTL: 銅 銅 銅
*. GBL: 銅 銅銅 銅
*. GBS: 銅 Soldermask
*. 銅銅: 銅 銅 銅
*. GBP: 銅 銅銅





pcb 1000, 1000 pcb 1000